

EV GROUP Expands Collaboration with ITRI on Heterogeneous Integration Process Development  
– August 31, 2022

## EV Group攜手工研院 擴大先進異質整合製程開發



蘇嘉維 / 台北報導

2022年8月31日 星期三 下午12:21



微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設備之領導廠商EV Group (EVG)，今日宣布攜手工業技術研究院 (以下簡稱工研院) 擴大先進異質整合製程的開發。

在半導體製造中，隨著超晶體微縮的更高效能需求提升，3D垂直堆疊與將多種不同的組件與晶粒，從製造、組裝到封裝至單一設備或封裝中的異質整合封裝技術，也促成了高頻寬互連，以提升整體系統的效率，更成為AI人工智慧、自動駕駛與其它高效能運算應用的關鍵驅動力。

經濟部多年前就看到此前瞻技術的發展潛力，積極推動「人工智慧晶片異質整合模組前瞻製造平台」及「可程式化異質3D整合」等國家級的研發專案；並支持工研院成立異質整合小晶片系統封裝聯盟 (Heterogeneous Integration Chip-let System Package Alliance; HI-CHIP)。協助打造包括封裝設計、測試與驗證，及試產生產的完整生態系，已逐步達成供應鏈在地化的目標，更成功擴展商機。

由於EVG是HI-CHIP聯盟成員之一，多套EVG最先進的晶圓接合與微影系統，包括LITHOSCALE 無光罩微影系統、EVG850 DB自動化剝離系統及GEMINI FB混合接合系統將於2022年底前進駐工研院3D-IC實驗室；未來將工研院的先進設備導入量產平台後，將協助雙方的共同客戶加速開發全新異質整合製程，拓展至客戶端的晶圓廠。

工研院電子與光電系統研究所副所長駱維仲表示，工研院的使命為帶動工業發展，創造經濟價值並透過科技的研發增進社會福祉，長期以來持續開發全新3D與異質晶片整合製程，並為供應鏈打造更緊密的合作關係，推進半導體產業持續發展與成長。

工研院的全自動化量產系統與合作業者的晶圓廠規格相同，包括來自EVG的全新晶圓接合與微影解決方案，有利於業者立即將工研院開發的製程配方導入生產過程，加速從實驗室到晶圓廠量產上市時程。

<https://tw.news.yahoo.com/ev-group%E6%94%9C%E6%89%8B%E5%B7%A5%E7%A0%94%E9%99%A2-%E6%93%B4%E5%A4%A7%E5%85%88%E9%80%B2%E7%95%B0%E8%B3%AA%E6%95%B4%E5%90%88%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E9%96%8B%E7%99%BC-042151933.html>